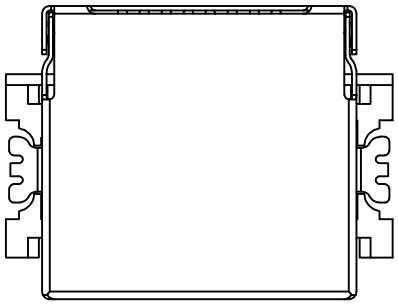
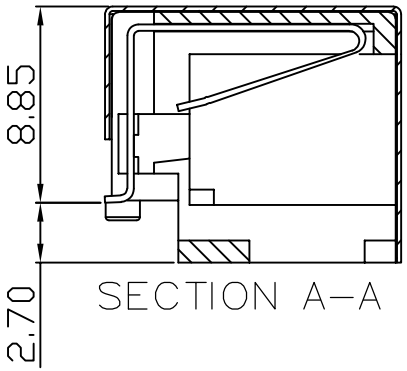
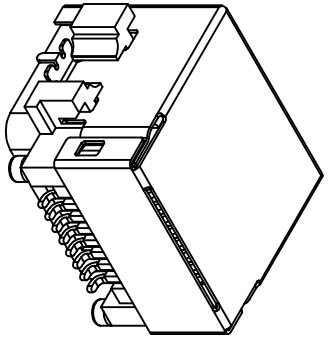
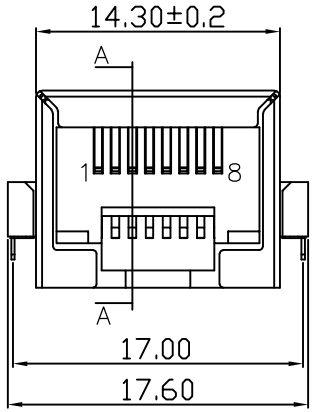
RoHS 2.0

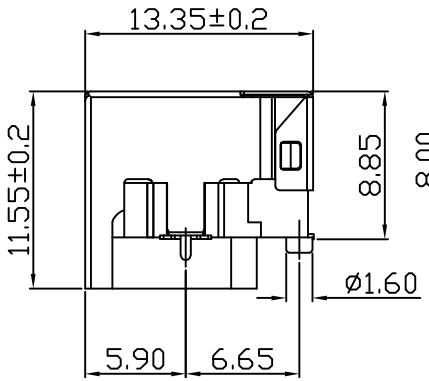


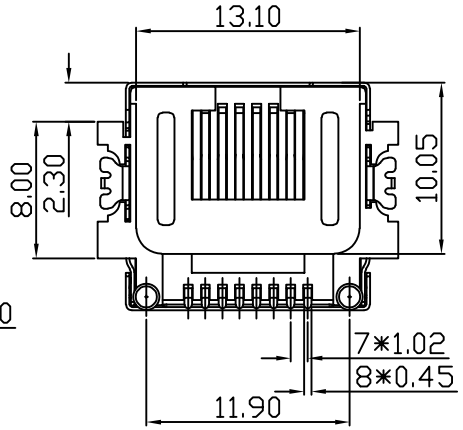


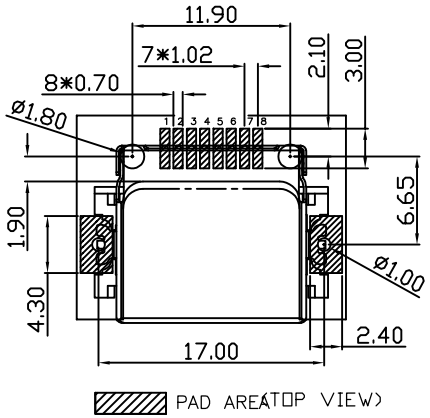



3D VIEW



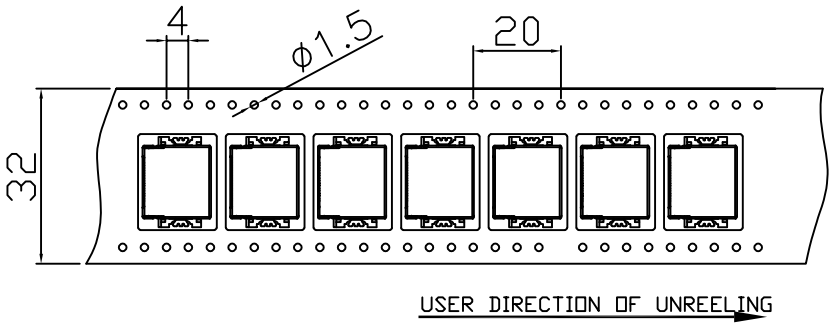



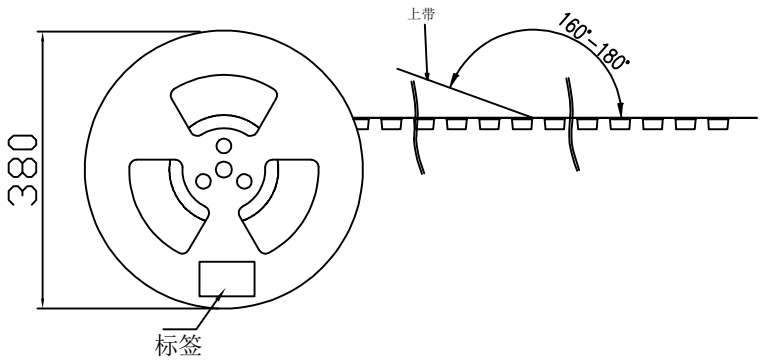



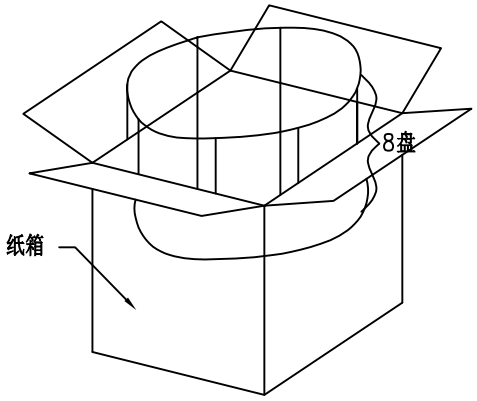

NOTES:

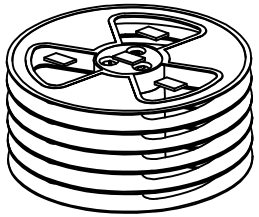
1. MATERIAL:
   1.1. HOUSING: LCP ,COLOR IS BLACK;
   1.2. CONTACT: COPPER
   1.3. SHELL: COPPER
2. FINISH:
   2.1. CONTACT: PLATED OVER NI,GOLD PLATED G/Fu";
   2.2. SHELL: PLATED OVER NI;
4. ELECTRICAL:
   4.1. VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS;
   4.2. CURRENT RATING: 1.5 AMP;
   4.3. CONTACT RESISTANCE: 35MILLIOHMS MAX.;
   4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
   4.5. INSULATION RESISTANCE: 500MEGOHMS MIN @500V DC.;
5. MECHANICAL:
   5.1. MATING/UNMATING FORCE: 22N MAX.;
   5.2. RETENTIION STRENGTH: 50N MIN.;
   5.3. OPERATING LIFE: 750 CYCLES MIN.;
6. ENVIRONMENTAL:
   6.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C~+85° C;
   6.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C~+70° C;
7. SALT SPRAY TEST:8H(EXCLUDING RIVETED BENDS)

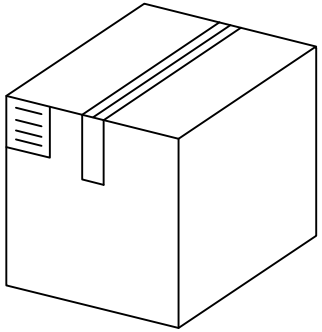
| 更改记录 | 标记 | 变更内容 | 签名/日期 | 未注公差 | 单位 | mm | 标准化 | 签名/日期 | 品名 | RJ沉板8.6全包铜壳编带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X.X ±0.30 | 版本 | A | 编制 | 周少华 21.09.25 | 图号 | ZJLQ-RJ45-055C-1 |
| | | | | X.XX ±0.20 | 比例 | 1:1 | 审核 | 赵先礼 21.09.25 | 浙江领强电子科技有限公司 | |
| | | | | X.XXX ±0.10 | 投影 | | 批准 | 田泽民 21.09.25 | | |
| | | | | Angle ±3.0° | 页次 | 1/1 | | | | |





注:

1. 纸箱为K=K材质
2. 每盘装400PCS,
3. 每箱装10盘 ,400*10=4000PCS
4. 未注明公差±0.2mm

| 更改记录 | 标记 | 变更内容 | 签名/日期 | 未注公差 | 单位 | mm | 标准化 | 签名/日期 | 品名 | RJ沉板8.6全包铜壳编带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X.X ±0.30 | 版本 | A | 编制 | 周少华 21.09.25 | 图号 | ZJLQ-RJ45-055C-1 |
| | | | | X.XX ±0.20 | 比例 | 1:1 | 审核 | 赵先礼 21.09.25 | 浙江领强电子科技有限公司 | |
| | | | | X.XXX ±0.10 | 投影 | | 批准 | 田泽民 21.09.25 | | |
| | | | | Angle ±3.0° | 页次 | 1/1 | | | | |

# 产品规范

## MODULAR JACK CONNECTOR

# 目　录


1. 范围…… 2
2. 参考文件…… 2
3. 结构 & 组成…… 2
4. 额定值…… 2
5. 测试环境…… 2
6. 外观…… 2
7. 测试条件与要求摘要…… 2
8. 包装，运输，储存…… 4
9. 温度 …… 4


| 版本 | ECN 编号 | 变更履历 | 日 期 | 签 名 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | N/A | 初版发行 | 2017.10.26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 产品规范

## MODULAR JACK CONNECTOR

**1. 范围**

本规范适用于 **MODULAR JACK CONNECTOR RJ45/RJ11** 系列产品。

**2. 参考文件**

除非特别说明，当此产品规范的要求与产品图有异议时以产品图为准；当此产品规范的要求与参考文件有异议时以产品规范为准。

A. EIA-364：电子连接器和插座类产品测试方法。

B. FCC 标准。

**3. 结构&组成**

产品的设计，结构和物理尺寸参照适用的产品图。

**4. 额定值**

| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 额定电压 | **125V** | AC(rms) |
| 额定电流 | **1.5A Max. at 25℃** | |
| 使用温度范围 | **-40℃ ~ +85℃** | |
| 使用湿度范围 | **95%R.H. MAXIMUM** | |

**5. 试验环境**

产品的设计应符合规定的电气, 机械及环境性能。除非特别说明之外，一般试验及测量将于温度 15~35℃，相对湿度 25~85%，大气压力 86 ~106kPa 之条件下完成，但若上述条件下有任何影响判定值的疑虑，可考虑在温度 20 ±2℃，相对湿度 60~70%及大气压力 86~106kPa 之条件下完成试验。

**6. 外观**

经目视观察，外观不可有变形，电镀脱落等会降低其功能的异常现象，也不可有严重破裂、刮伤或污损之缺点。

**7. 测试条件及要求摘要**

7.1 电气特性

| 编号 | 项 目 | 条 件 | 规 格 |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | 接触阻抗 | EIA364-23<br>在配对好公头与插座上进行测试.<br>开路电压：20mV 以下<br>电流：100mA 以下 | 35mΩ Max. |
| 7.1.2 | 绝缘阻抗 | EIA364-21<br>在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。<br>电压：500V DC. | 1000MΩ Min。 |
| 7.1.3 | 耐电压 | EIA 364-20<br>在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。<br>电压：1000V AC 50 或 60HZ，持续 1 分钟。 | 无击穿或火花发生<br>漏电流：< 1.5mA |

# MODULAR JACK CONNECTOR

7.2 MECHANICAL PERFORMANCE［机械特性］

| 编号 | 项 目 | 条 件 | 规 格 | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | 插入力 | EIA 364-13<br>操作速度：不超过 10mm/秒速度，测量插入水晶头所需的力。 | 22N (2.24Kgf) Max. | |
| 7.2.2 | 拔出力 | EIA 364-13<br>操作速度：不超过 10mm/秒速度，测量拔出水晶头所需的力。(水晶头除去锁扣舌片) | 22N (2.24Kgf) Max. | |
| 7.2.3 | 配合强度 | EIA 364-98<br>配对插头与插座，以不超过 10mm/秒的速度，测量拔出插头所需的力。 | 50N (5.10Kgf) Min. | |
| 7.2.4 | 机械寿命 | EIA 364-09<br>操作速度：不超过 300 次/小时和 10mm/秒速度，插拔次数：750 次，水晶头锁扣舌片处于无功能状态。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50mΩ Max. |
| 7.2.5 | 可焊性 | EIA 364-52<br>产品锡脚放置在助焊剂中浸润 5S 后再插入锡炉中 2mm 深进行粘锡测试。<br>焊锡温度：245±3℃；<br>焊锡时间：5±0.5 秒（使用助焊剂）。 | 最少 95%的沾锡面积。 | |

7.3 环境特性及其它

| 编号 | 项 目 | 条 件 | 规 格 | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 | 耐焊接热 | EIA 364-56<br>人工焊：3±1 秒 350±10℃；<br>自动焊：260±5 ℃，10±1秒 | 外观 | 不可损坏 |
| 7.3.2 | 耐高温 | EIA-364-17<br>配对插头与插座，温度 85±2℃，持续 96 小时。经试验后，连接器须于室温中放置 1~2 小时，再测定其值。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50 mΩ Max. |
| 7.3.3 | 耐低温 | EIA-364-59<br>配对插头与插座，温度-40±2℃，持续 96 小时。经试验后，连接器须于室温中放置 1~2 小时，再测定其值。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50 mΩ Max. |

（继续）

## MODULAR JACK CONNECTOR

| 编号 | 项 目 | 条 件 | 规 格 | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.4 | 温度循环 | EIA-364-32<br>配对插头与插座，在温度-40±2℃箱体内放置 0.5 小时,然后在 85±2℃箱体中放置 0.5 小时，5 个循环后取出样品在室温中恢复 1~2 小时。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50 mΩ Max. |
| 7.3.5 | 耐湿性 | EIA 364-31<br>配对插头与插座，在温度 40±2℃,湿度 90~95%RH 的箱体内放置 96 小时，取出样品在室温中恢复 1~2 小时。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50 mΩ Max. |
| | | | 绝缘阻抗 | 500 MΩ MIN. |
| | | | 耐电压 | 500 VAC，1 分钟 |
| 7.3.6 | 盐水喷雾 | EIA-364-26<br>将配对的插头与插座放置于 PH 值为 6.5~7.2 的 5±1% Nacl 盐雾环境中，测试完成后，用清水冲洗样品，在室温中恢复 1 小时。<br>盐雾时间（镀金）：<br>（Fu"、G/F）：12 小时，<br>（3u"~10u"）：24 小时，<br>（15u"~30u"）：48 小时。 | 外观 | 不可损坏 |
| | | | 接触阻抗 | 50 mΩ Max. |

注意：产品如果是由 PBT 组成，在焊接过程中定位柱可能会出现熔胶现象（熔胶温度为≥230℃，时间为 3 秒后）。

（结束）

**8. 包装、运输、储存**

8.1 包装

产品应装在干燥的、防潮的、防尘和防霉箱子中。包装箱的外表部应注明相应产品名称、型号、料号、数量以及日期、检验印章等。

8.2 运输

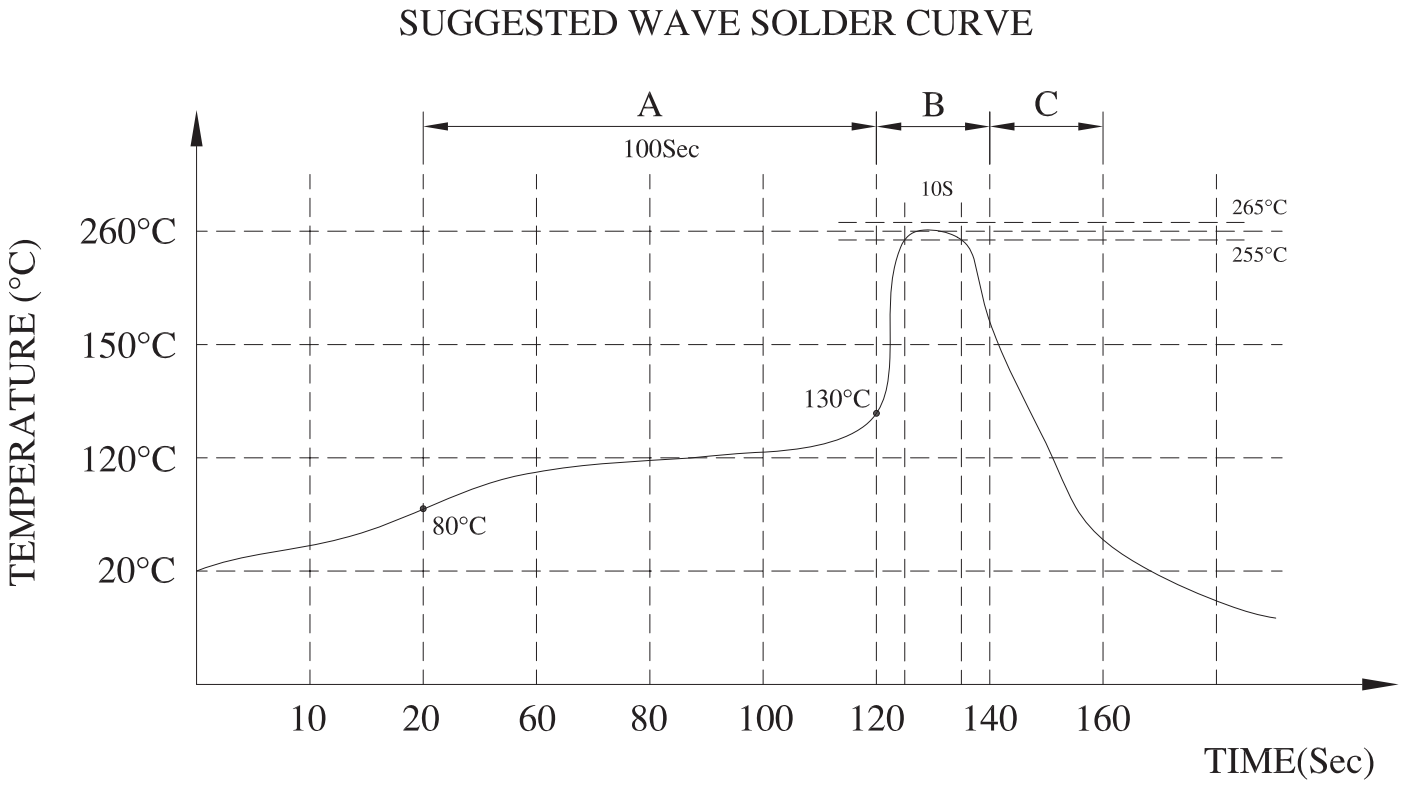
包装成箱的产品，在避免雨雪直接淋袭的条件下，可用任何运输工具运送。

8.3 储存

包装成箱的产品，建议在环境温度-10～+40℃，相对湿度不大于 80%内保管，应储存在周围空气中没有酸性、碱性或其它腐蚀性气体的库房中。若需长期保存，请勿打开包装箱。

## MODULAR JACK CONNECTOR

9. 波峰焊曲线图




A. Preheating B. Soldering C. Gradual Cooling